

Datum: 08.07.2019

## **SX-PCEAC2 WiFi/ Bluetooth Kombi Modul**

HY-LINE Communication Products präsentiert das leistungsfähige Dual Band WiFi Bluetooth Modul SX-PCEAC2 von Silex Technology mit M.2 LGA und Half Size Mini Card Option.

Das Modul basiert auf dem Qualcomm Atheros-Funkchip QCA6174-5 mit 2x2 Wave 2 MU-MIMO-Technologie. Das SX-PCEAC2 ist ein Dual-Band 802.11 a / b / g / n / ac-Modul mit Bluetooth-Unterstützung für drahtlose Applikationen mit kleinen Formfaktor und hohen Datendurchsätzen von bis zu 867 Mbit / s. Es ist ideal für Embedded-Anwendungen wie Medizintechnik, Sicherheitssysteme und Industrie-PC's.

Das SX-PCEAC2 ist in verschiedenen Formfaktoren für unterschiedliche Anforderungen erhältlich. Die Oberflächenmontageoption M.2 LGA Typ 1216 bietet den geringsten Platzbedarf, während der Formfaktor Half Size Minicard für die Integration bzw. Aufrüstung auf eine 802.11ac-Lösung älterer PCIe-basierende Geräte geeignet ist.

Highlights:

- Dual-Band 802.11ac Wave2 mit MU-MIMO-Technologie
- Mehrere Formfaktoren für unterschiedliche Anforderungen
- Ultrahochgeschwindigkeitsdatenraten von bis zu 867 Mbit / s
- Enterprise Security EAP (802.1x Authentication Protocol)
- Unterstützung vom Entwurf bis zur Herstellung
- Modulare Zertifizierungen und Zulassungen für FCC (USA), IC (Kanada), ETSI (Europa), MIC (Japan) verfügbar

Weitere Informationen:

[www.hy-line.de/silex/sx-pceac2](http://www.hy-line.de/silex/sx-pceac2)

Bild: PM\_SX-PCEAC2.jpg

erstellt für: HY-LINE Communication Products  
Carsten Pfaff  
Inselkammerstr. 10; D-82008 Unterhaching  
Tel.: 089/614503-236 ; Fax: 089/6140960  
E-Mail: c-pfaff@hy-line.de ; Web: www.hy-line.de/communication

erstellt von: Oliver Gropp, HY-LINE Holding, Tel. 089/614503-48 Email: [o-gropp@hy-line.de](mailto:o-gropp@hy-line.de)